

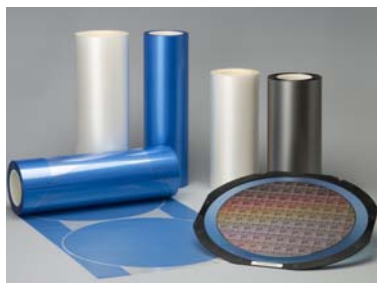
半導体の需要拡大と一層の薄膜化、多積層化を受け 関連テープの新規生産設備を導入

当社では、昨今の半導体需要の急拡大と半導体メーカー各社の積極的な増産投資、そして飛躍的な技術革新などを受けて、吾妻工場(群馬県)において約45億円を投じ、半導体の製造工程や実装に欠かせない関連テープの最新鋭生産設備を新たに導入し、生産能力の増強と製品品質の一層の向上を図ることにしました。

半導体製造に欠かせない、独自技術を生かした 特殊粘着テープの増産投資を実施

当社では、回路形成後の半導体ウェハを薄型化するための裏面研削工程で回路面を保護するウェハ表面保護テープや、ウェハをチップに切断する際にはしっかりと固定し、さらにチップを基板に実装する際には接着剤として使われるウェハ裏面固定・チップ実装用テープ、あるいはチップを反転させて実装するフリップチップ裏面保護テープなど、半導体の製造工程や実装に欠かせない特殊粘着テープを各種開発・提供しています。

昨今、スマートフォンや電気自動車(EV)・高速通信規格「5G」向け需要などを受けて半導体需要が急拡大しており、需給が逼迫しています。半導体メーカー各社では積極的な増産投資を行っており、当社においても今後のさらなる市場拡大に向け、より高品質な製品の安定供給体制を強化するため、新たな増産投資を実施することになりました。



半導体関連テープ

一層の半導体需要拡大と技術革新に対応すべく 最新鋭の生産設備を導入

今回、当社グループの半導体関連製品の中核生産拠点である吾妻工場において、2023年12月の竣工をめどに約45億円を投じて、最新鋭の新規クリーン塗工設備1台および裁断設備2台、自動ラック棟などを導入。ウェハ表面保護テープなどの厚み精度の向上や、自動車規格に対応した品質保証体制のさらなる強化を図るほか、各種テープの安定供給を実現できる体制を構築していきます。

当社では今後も引き続き、半導体メーカー各社の増産投資や技術革新への対応を図るべく、エレクトロニクス関連市場に向けた積極的な新製品開発と高品質製品の安定供給を継続的に推進していきけるよう、体制面の強化を図っていく考えです。



新規設備を導入する吾妻工場の既存工棟

■リリース内容に関するお問い合わせ

リンテック株式会社 広報・IR室

〒173-0001 東京都板橋区本町 23-23 TEL. (03)5248-7741 FAX. (03)5248-7754 担当:阿部

※本リリースに使用している写真データは、<https://www.lintec.co.jp/pub/>からダウンロードいただけます。